

# 半導体実装業界マップ

2022年7月27日

大阪大学産業科学研究所フレキシブル3D実装協働研究所

## 1. 公開目的

半導体実装(\*)に関するビジネス機会創出・拡大のため、F3D実装コンソーシアム参加メンバー（企業や大学等）が有する情報を基に業界マップを作成し、世の中に情報発信する。

\*パワー半導体、先端AI・IoT半導体の実装を対象とする

## 2. 作成

大阪大学産業科学研究所フレキシブル3D実装協働研究所（F3D研究所）

F3Dコンソーシアム

## 3. 内容

### (1)マップの種類

- ・製品化企業等一覧：製品化している企業名等の一覧
- ・製品等詳細：各企業・大学等の製品・技術名、カテゴリ、特徴・アピール点を掲載

### (2)カテゴリー

実装構成部材を念頭に、以下の8項目にカテゴリー化

- ①ワイヤ
- ②ダイアタッチ材
- ③モールド樹脂
- ④基板・ベース（リードフレーム）
- ⑤放熱板・フィン
- ⑥製造装置・評価装置
- ⑦信頼性評価・検査（計測評価含む）
- ⑧その他

今後、より分かりやすい表記とすべくカテゴリー自体を見直す可能性有り

## 4. 業界マップの取扱いについて

- ・改編、改ざん、販売を禁止する
- ・問合せ先：

F3D研究所 加藤豊 TEL：06-6879-4295 e-mail：[katoyu@sanken.osaka-u.ac.jp](mailto:katoyu@sanken.osaka-u.ac.jp)

## 5. 業界マップの見方

### (1)製品化企業等一覧

- ・サプライチェーンを考慮しながら実装構成部材をカテゴリー化、カテゴリーごとに該当企業名等を掲載

### (2)製品等詳細

- ・ カテゴリー化は製品化企業等一覧に同じ
- ・ カテゴリーごとに色分けし、製品・技術の詳細を表記

企業名
製品（技術）名
カテゴリー
製品・技術の特徴・アピール点

基板・ベース		ダイアタッチ材	
モールド樹脂		放熱板・フィン	
ワイヤ		その他	
製造装置・評価装置		信頼性評価・検査	

- ・ 企業名を選択するとリンクが開き、製品やその技術情報等を見ることが出来る。  
(製品情報先がない場合は、その企業等のホームページに移行する)

以上